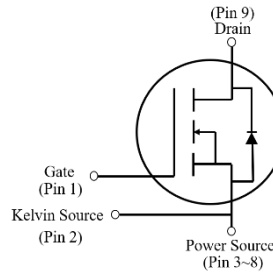


## IV1Q06060L1G – 650V 60mΩ SiC MOSFET

### 特点

- 高压、低导通电阻
- 高速、寄生电容小
- 高工作结温
- 快速恢复体二极管
- 开尔文连接驱动

### 封装示意图:

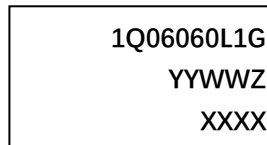


### 应用

- UPS 电源
- 电机驱动
- EV/HEV 驱动
- 高压 DC/DC 变换器
- 开关电源

TOLL

### 丝印示意图:



1Q06060L1G= Specific Device Code  
YY = Year  
WW = Work Week  
Z = Assembly Location  
XXXX = Lot Traceability

### 最大额定值 (T<sub>c</sub>=25°C, 特殊说明除外)

符号	参数说明	典型值	单位	测试条件	备注
V <sub>DS</sub>	漏源电压	650	V	V <sub>GS</sub> =0V, I <sub>D</sub> =100μA	
V <sub>GSmax</sub> (DC)	最大直流栅源电压	-5 to 22	V	静态 (DC)	
V <sub>GSmax</sub> (Spike)	最大尖峰栅源电压	-10 to 25	V	<1%占空比, 脉冲宽度 <200ns	
V <sub>GSon</sub>	推荐使用的开通栅源电压	20±0.5	V		
V <sub>GSoff</sub>	推荐使用的关断栅源电压	-3.5 to -2	V		
I <sub>D</sub>	最大漏源电流	46	A	V <sub>GS</sub> =20V, T <sub>C</sub> =25°C	图 21
		33	A	V <sub>GS</sub> =20V, T <sub>C</sub> =100°C	
I <sub>DM</sub>	最大脉冲漏源电流	115	A	根据器件安全工作区确定	图 24
P <sub>TOT</sub>	最大耗散功率	181	W	T <sub>C</sub> =25°C	图 22
T <sub>stg</sub>	存储温度范围	-55 to 175	°C		
T <sub>J</sub>	工作结温范围	-55 to 175	°C		
T <sub>L</sub>	焊接温度	260	°C	引线处波峰焊接, 距外壳 1.6 毫米, 持续不超过 10 秒	

### 热阻特性

符号	参数说明	典型值	单位	备注
R <sub>θ(j-c)</sub>	结到外壳的热阻	0.824	°C/W	图 23

电学特性 (T<sub>c</sub>=25°C, 特殊说明除外)

符号	参数说明	规范值			单位	测试条件	备注
		最小	典型	最大			
I <sub>DSS</sub>	关断时的漏极漏电流		5	100	μA	V <sub>DS</sub> =650V, V <sub>GS</sub> =0V	
I <sub>GSS</sub>	栅极漏电流			±100	nA	V <sub>DS</sub> =0V, V <sub>GS</sub> =-5~20V	
V <sub>TH</sub>	阈值电压	1.8	2.8	5	V	V <sub>GS</sub> =V <sub>DS</sub> , I <sub>D</sub> =3.9mA	图 8, 9
			2.1			V <sub>GS</sub> =V <sub>DS</sub> , I <sub>D</sub> =3.9mA @ T <sub>J</sub> =175°C	
R <sub>ON</sub>	导通电阻		60	80	mΩ	V <sub>GS</sub> =20V, I <sub>D</sub> =15A @T <sub>J</sub> =25°C	图 4, 5, 6, 7
			80		mΩ	V <sub>GS</sub> =20V, I <sub>D</sub> =15A @T <sub>J</sub> =175°C	
C <sub>iss</sub>	输入电容		1640		pF	V <sub>DS</sub> =600V, V <sub>GS</sub> =0V, f=1MHz, V <sub>AC</sub> =25mV	图 16
C <sub>oss</sub>	输出电容		130		pF		
C <sub>rss</sub>	反向传输电容		4.2		pF		
E <sub>oss</sub>	输出电容存储能量		25		μJ		图 17
Q <sub>g</sub>	栅极总电荷		69.5		nC	V <sub>DS</sub> =400V, I <sub>D</sub> =15A, V <sub>GS</sub> =-5V to 20V	图 18
Q <sub>gs</sub>	栅源电荷		21.8		nC		
Q <sub>gd</sub>	栅漏电荷		21.6		nC		
R <sub>g</sub>	栅极输入电阻		2		Ω	f=1MHz	
E <sub>ON</sub>	导通能量		84.4		μJ	V <sub>DS</sub> =400V, I <sub>D</sub> =15A, V <sub>GS</sub> =-3.5V to 20V, R <sub>G(ext)</sub> =4.7Ω, L=250μH	图 19, 20
E <sub>OFF</sub>	关断能量		16.7		μJ		
t <sub>d(on)</sub>	导通延迟时间		7.2		ns		
t <sub>r</sub>	上升时间		11.5				
t <sub>d(off)</sub>	关断延迟时间		21				
t <sub>f</sub>	下降时间		10.2				

体二极管特性 (T<sub>c</sub>=25°C, 特殊说明除外)

符号	参数说明	规范值			单位	测试条件	备注
		最小	典型	最大			
V <sub>SD</sub>	正向电压		3.8		V	I <sub>SD</sub> =15A, V <sub>GS</sub> =0V	图 10, 11, 12
			3.5		V	I <sub>SD</sub> =15A, V <sub>GS</sub> =0V, T <sub>J</sub> =175°C	
t <sub>rr</sub>	反向恢复时间		11.3		ns	V <sub>DS</sub> =400V, I <sub>D</sub> =15A, V <sub>GS</sub> =-3.5V to 20V, R <sub>G(ext)</sub> =15Ω, L=250μH di/dt=3000A/μs	
Q <sub>rr</sub>	反向恢复电荷		100.3		nC		
I <sub>RRM</sub>	反向恢复峰值电流		17.7		A		

典型特征曲线

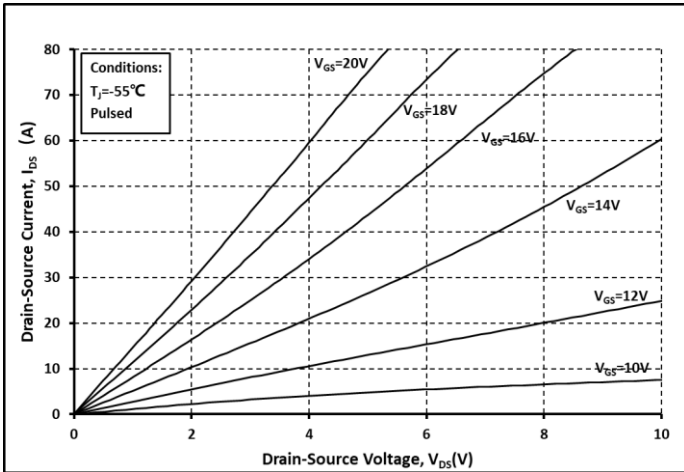


图. 1 输出曲线 @  $T_j = -55^\circ\text{C}$

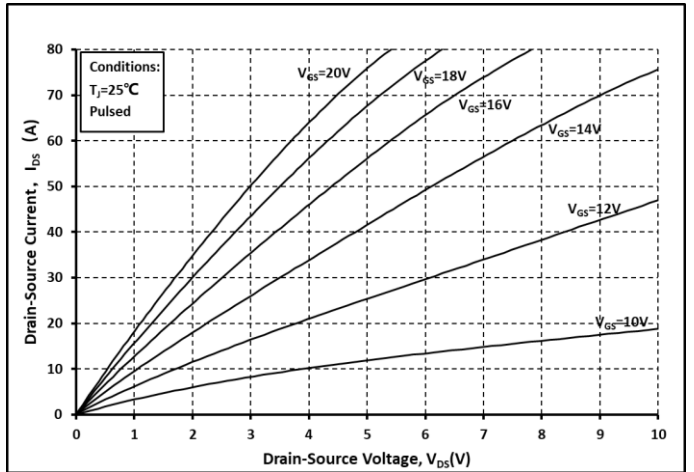


图. 2 输出曲线 @  $T_j = 25^\circ\text{C}$

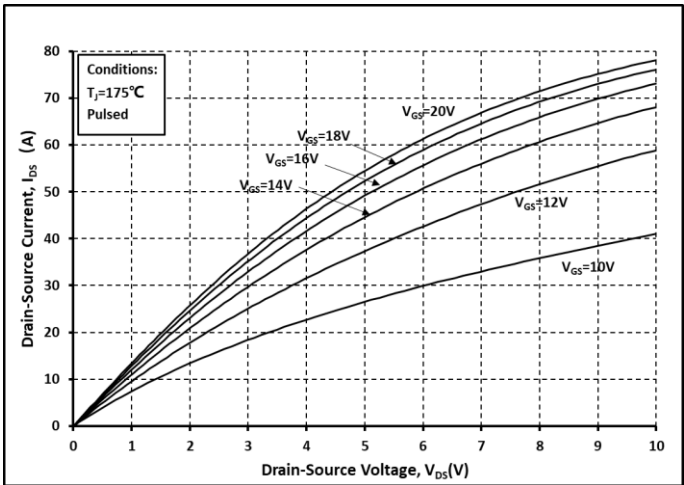


图. 3 输出曲线 @  $T_j = 175^\circ\text{C}$

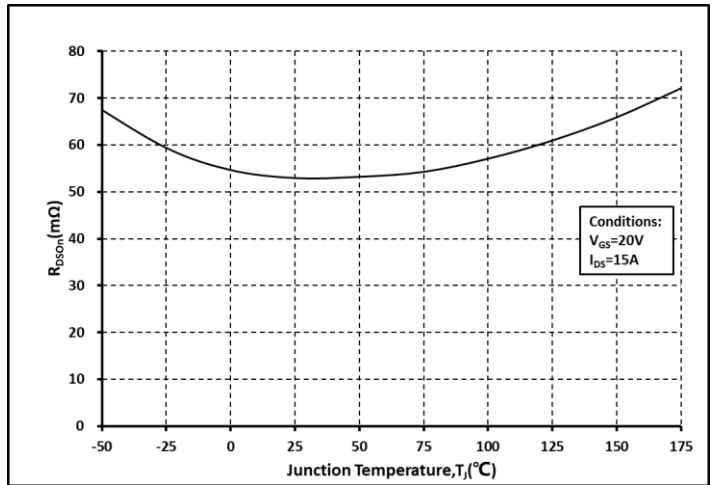


图. 4  $R_{on}$  和温度关系曲线

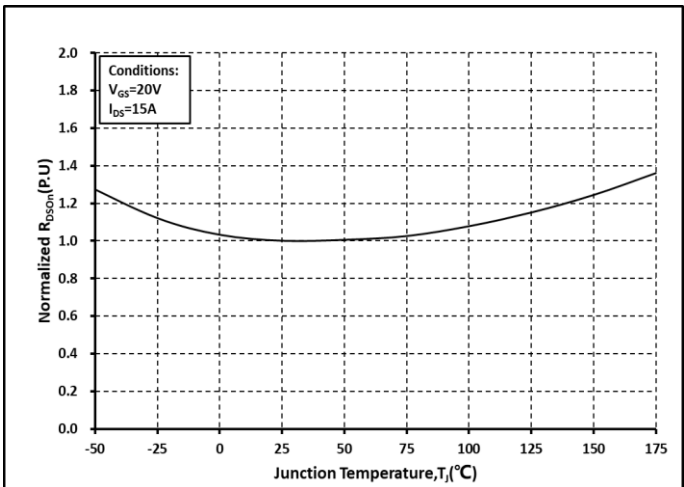


图. 5 归一化的  $R_{on}$  和温度关系曲线

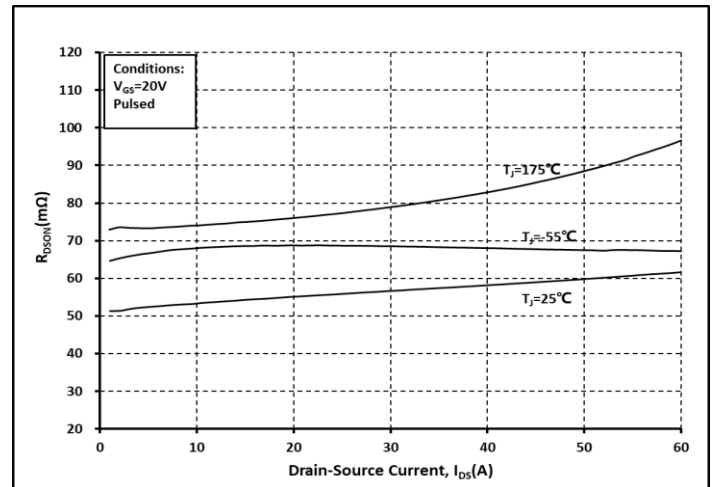


图. 6 各温度下的  $R_{on}$  和  $I_{DS}$  关系曲线

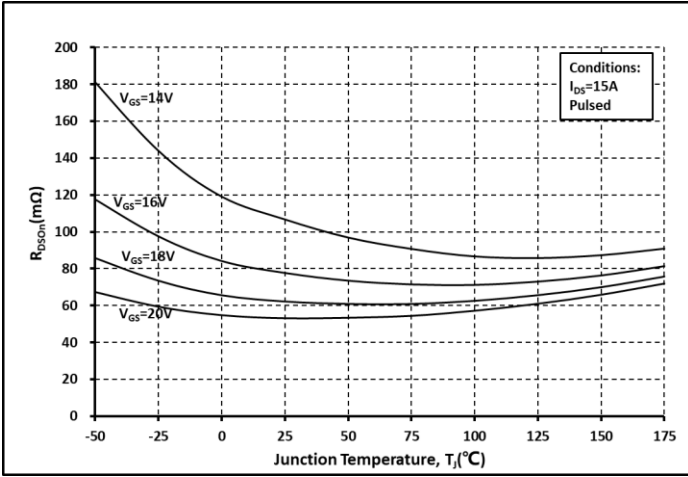


图. 7 各  $V_{GS}$  下的  $R_{on}$  和温度关系曲线

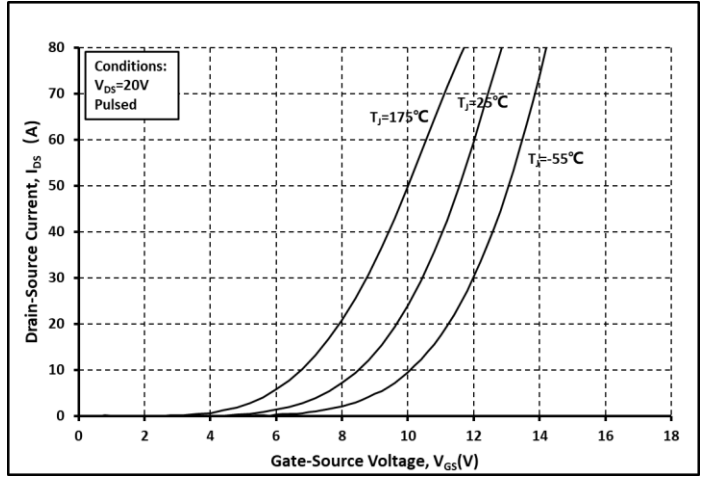


图. 8 各温度下的传输特性曲线

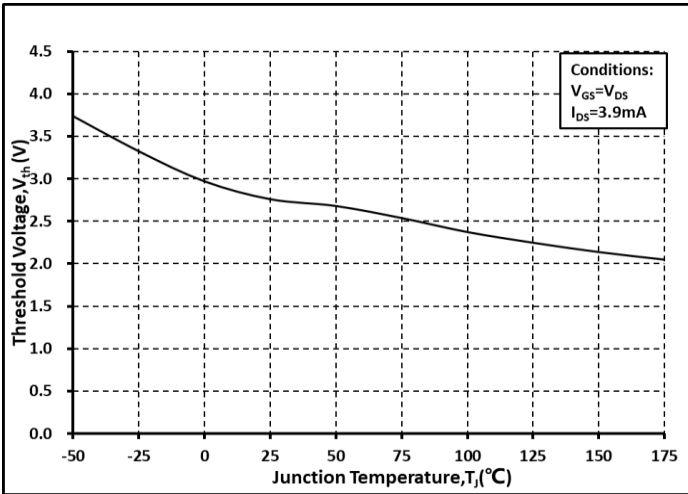


图. 9 阈值电压随温度变化曲线

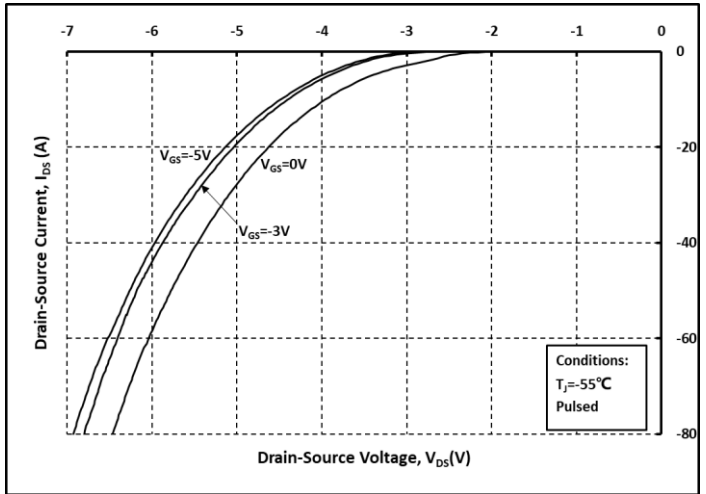


图. 10 体二极管导通曲线 @  $T_j = -55^\circ\text{C}$

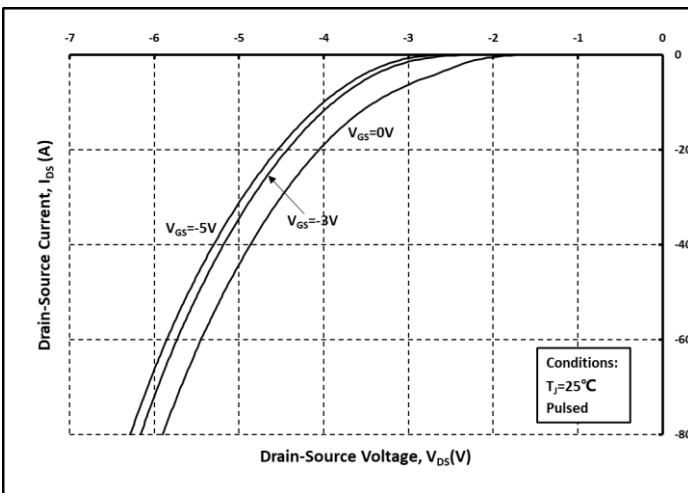


图. 11 体二极管导通曲线 @  $T_j = 25^\circ\text{C}$

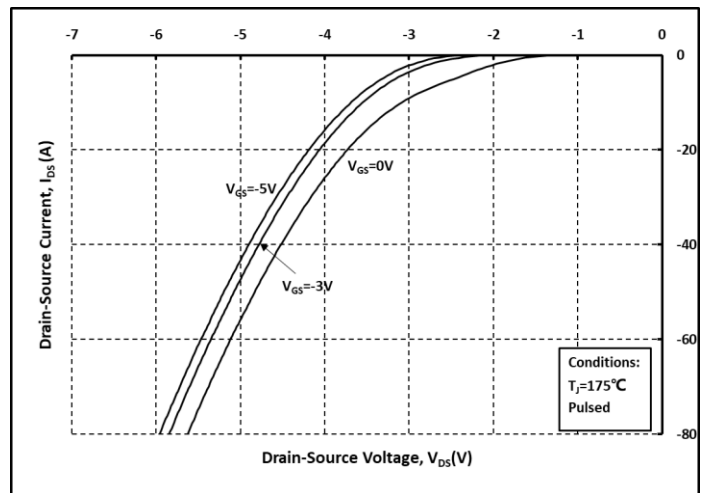


图. 12 体二极管导通曲线 @  $T_j = 175^\circ\text{C}$

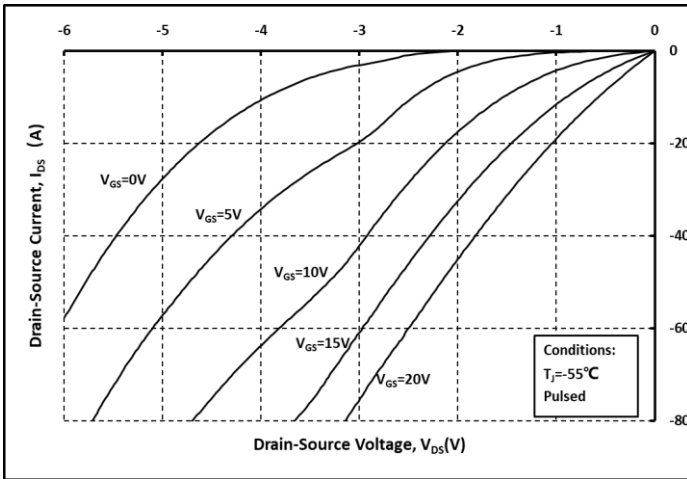


图. 13 第三象限曲线 @  $T_j = -55^\circ\text{C}$

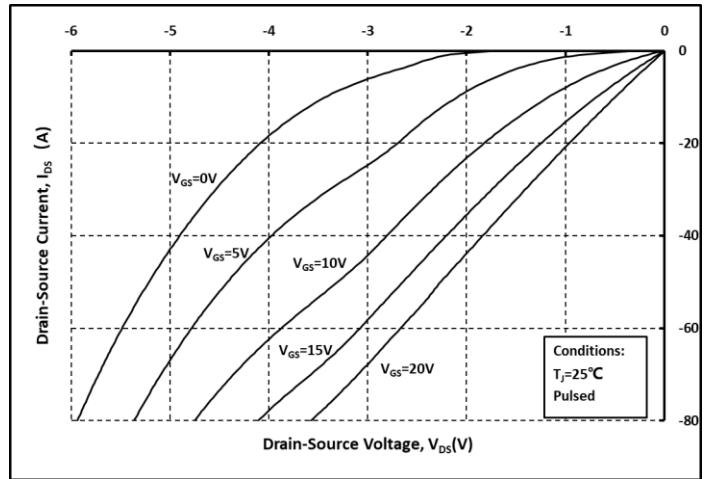


图. 14 第三象限曲线 @  $T_j = 25^\circ\text{C}$

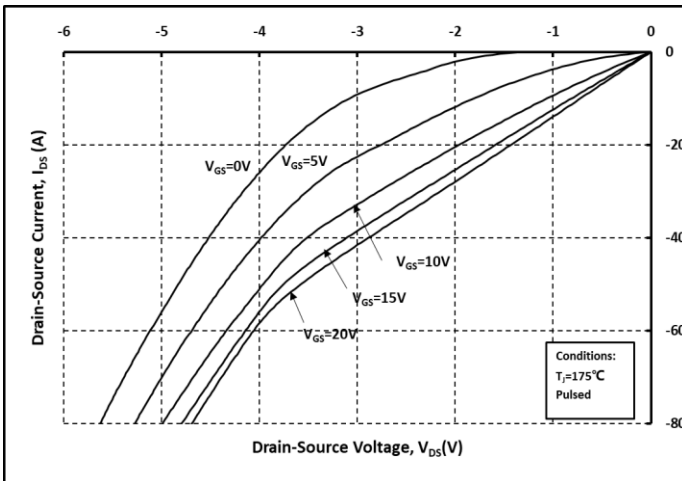


图. 15 第三象限曲线 @  $T_j = 175^\circ\text{C}$

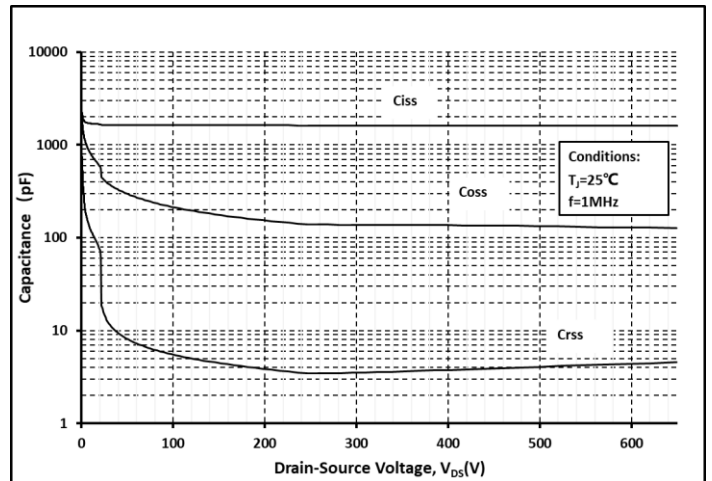


图. 16 各电容和  $V_{DS}$  关系曲线

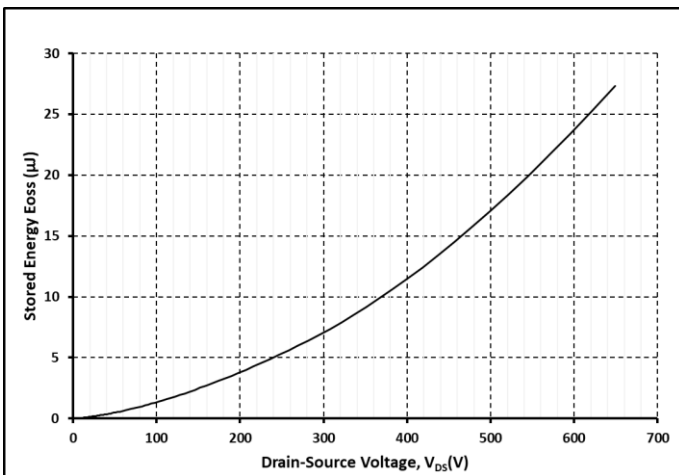


图. 17 输出电容存储能量曲线

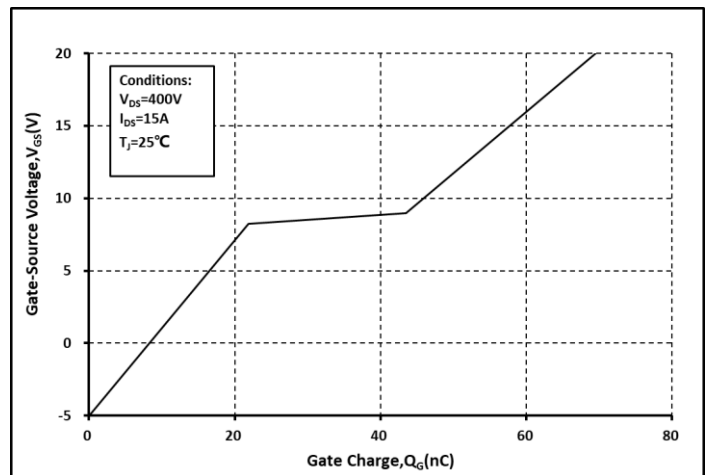


图. 18 栅电荷特征曲线

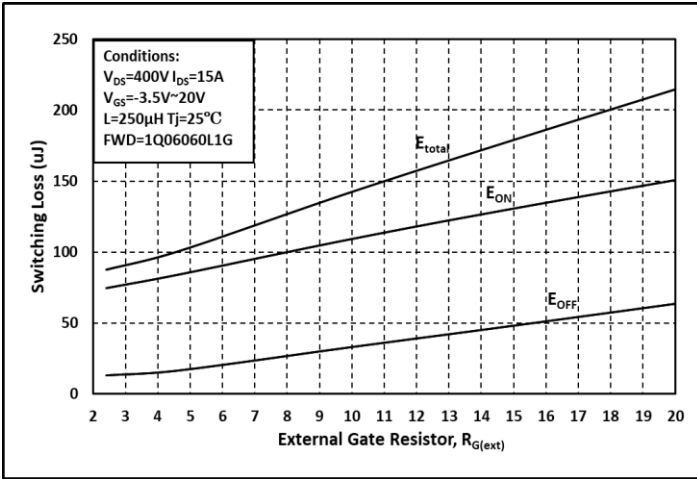


图. 19 开关能量和栅极电阻  $R_{G(ext)}$  关系曲线

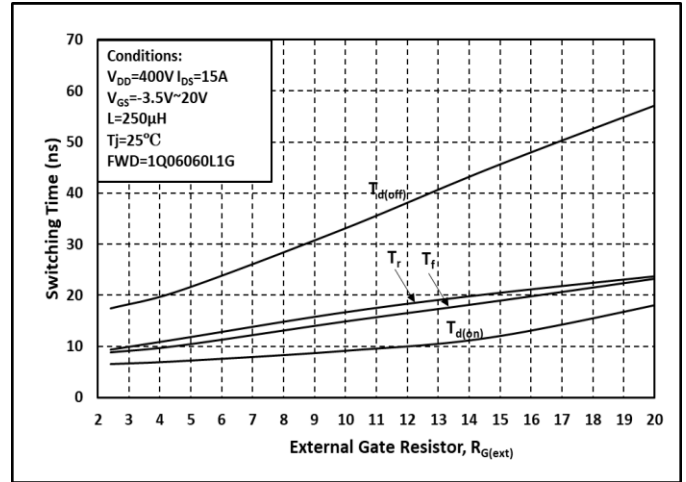


图. 20 开关时间和栅极电阻  $R_{G(ext)}$  关系曲线

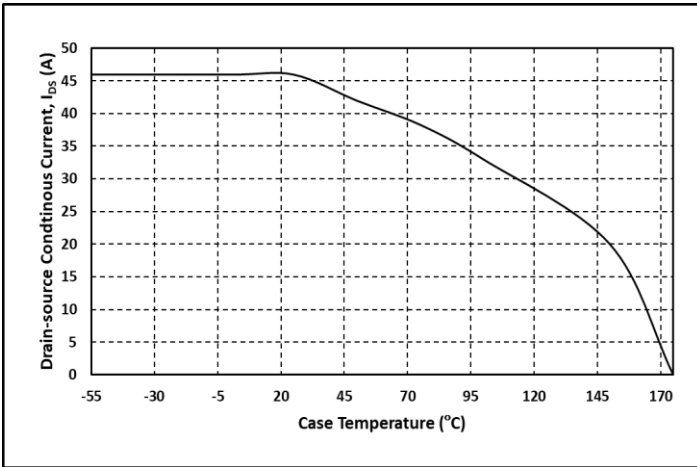


图. 21 漏端电流和温度关系曲线

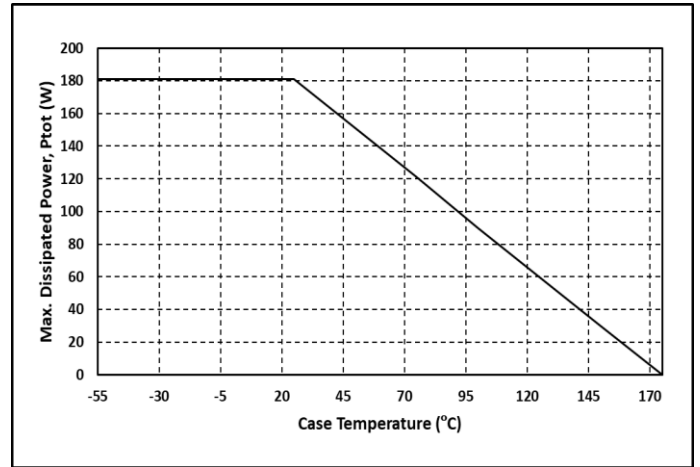


图. 22 最大功耗降额和温度关系曲线

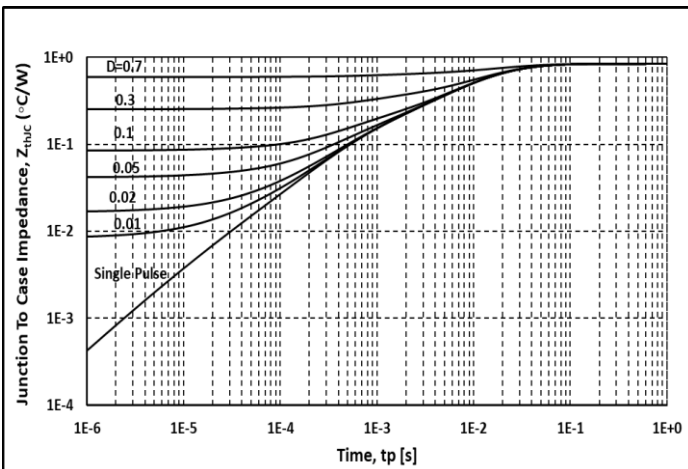


图. 23 热阻曲线

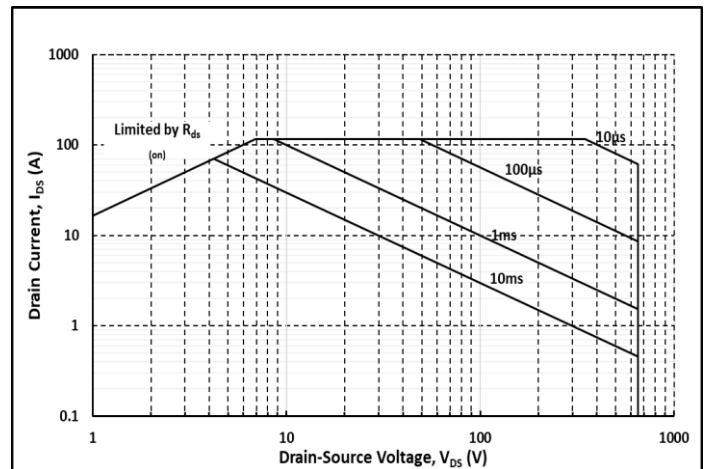
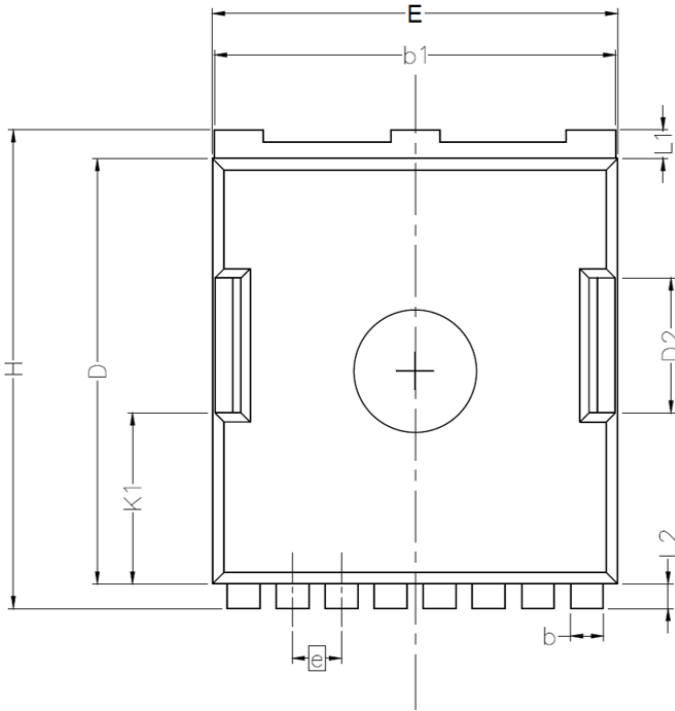
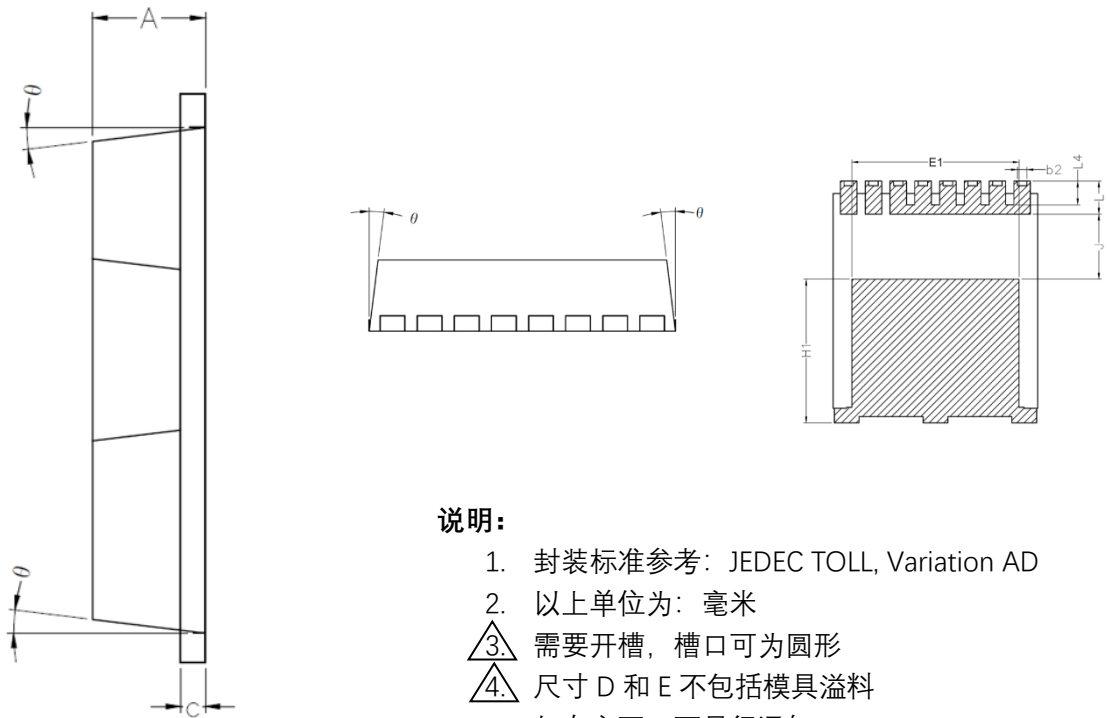


图. 24 安全工作区示意图

封装尺寸



Dimensions In Millimeters		
SYMBOL	MIN.	MAX.
A	2.20	2.40
b	0.70	0.90
b1	9.70	9.90
b2	0.42	0.50
c	0.40	0.60
D	10.28	10.58
D2	3.10	3.50
E	9.7	10.10
E1	7.90	8.30
e	1.20 BSC	
H	11.48	11.88
H1	6.75	7.15
N	8	
J	3.00	3.30
K1	3.98	4.38
L	1.40	1.80
L1	0.60	0.80
L2	0.50	0.70
L4	1.00	1.30
θ	4°	10°



说明:

1. 封装标准参考: JEDEC TOLL, Variation AD
  2. 以上单位为: 毫米
  3. 需要开槽, 槽口可为圆形
  4. 尺寸 D 和 E 不包括模具溢料
1. 如有变更, 不另行通知



## 说明

欲了解更多的产品及公司信息，敬请联系 IVCT 公司办公人员或登录公司网站。

Copyright©2022 InventChip Technology Co., Ltd. All rights reserved.

本文档中的信息如有变更，恕不另行通知。

## 相关链接

<http://www.inventchip.com.cn>





单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>Inventchip\(瞻芯电子\)](#)